

2015年全球及中国IC载板行业研究报告

《2015年全球及中国IC载板行业研究报告》包含以下内容：

- 1、半导体与IC封装行业概况
 - 2、IC载板下游市场分析
 - 3、IC载板发展趋势
 - 4、IC载板产业分析
 - 5、12家IC载板厂家研究
 - 6、6家IC载板周边厂家研究
-
- IC载板（基板，Substrate）行业在2015年可能面临困境，一方面是FOWLP的日渐成熟，另一方面则是平板电脑销量下滑，智能手机增长乏力。另外，2013年的繁荣刺激企业在2014年大规模扩产，导致产能利用率不足。
 - 对于手机和平板电脑领域为核心市场的FC-CSP基板面临来自FOWLP的强力竞争，FOWLP具备压倒性的优势，包括低封装高度（Low Profile），更高速度，更多I/O，更高集成度（Higher Integration），更简单的工艺（less processing step），最重要是无需载板，大幅度降低成本，IC载板占IC总成本的比例超过50%。

- 尽管FOWLP目前还不成熟，成本优势并不明显，但这已经是大势所趋，传统FC-CSP基板将不得不降价来与FOWLP竞争。一旦FOWLP成熟，那么FC-CSP基板的需求量会骤减60%以上。所以2015年，FC-CSP基板厂家必须大幅度降价来提前获得市场优势。预计2015年IC载板市场规模缩小7%，为71.2亿美元。
- 下游市场方面，大屏幕手机严重挤压平板电脑生存空间，平板电脑下滑明显。并且平板电脑功能单一，通常只是做儿童玩具，更新换代需求很少。智能手机领域，中国作为全球最大的智能手机市场，在2014年已经出现下滑。
- 2015年IC载板市场最大亮点是SiP封装基板，也就是智能手表，高端智能手表的核心元件必须采用SiP封装。Apple Watch内建二颗重要核心处理器，均采用SiP封装技术。Apple Watch最重要的SiP基板生产难度最高，价格比一般ARM处理器采用的晶片尺寸覆晶基板（FCCSP）高出4~5倍，订单则由南电（Nanya）、景硕（Kinsus）等台湾厂商分食。日月光（ASE）承接Apple Watch的S1晶片SiP封测业务。
- 此外，2015年PC市场也有可能回暖，因为平板电脑下滑也就意味着笔记本电脑市场复苏，笔记本电脑市场连续3年下滑后在2014年第一次增长，预计2015年继续增长。且笔记本电脑内建独立显卡比例大幅度升高，意味着GPU出货量大增。
- IC载板应用市场中，表现较好的还有Memory市场。



2012-2014年主要IC载板厂家收入（百万美元）

	2012	2013	2014
UNIMICRON	925	747	752
IBIDEN	1482	1110	1002
NANYA	645	702	806
KINSUS	694	613	649
SEMCO	1230	1048	882
SHINKO	1460	1200	1130
SIMMTECH	336	298	390
DAEDUCK	382	386	372
KYOCERA	286	260	308
LG INNOTEK	110	245	351
ASE	174	192	218



报告目录

第一章、全球半导体产业

- 1.1、全球半导体产业概况
- 1.2、IC封装概况
- 1.3、IC封测产业概况

第二章、IC载板下游市场

- 2.1、IC载板简介
- 2.2、FLIP CHIP IC 载板
- 2.3、全球手机市场
- 2.4、全球智能手机市场
- 2.5、中国手机市场
- 2.6、平板电脑市场
- 2.7、CPU与GPU市场
- 2.8、内存市场

第三章、IC载板市场与产业

- 3.1、IC载板市场
- 3.2、WIDE IO/HMC MEMORY
- 3.3、EMBEDDED COMPONENT SUBSTRATE
- 3.4、EMBEDDED TRACE SUBSTRATE

3.5、手持设备IC封装 IC PACKAGING FOR HANDSET

- 3.5.1、手持设备IC封装现状
- 3.5.2、PoP封装
- 3.5.3、FOWLP
- 3.6、SIP封装
- 3.7、2.5D封装（SI/GLASS/ORGANIC INTERPOSER）
 - 3.7.1、2.5D封装简介
 - 3.7.2、2.5D封装应用
 - 3.7.3、2.5D Interposer市场规模
 - 3.7.4、2.5D 封装供应商
- 3.8、TSV（3D）封装
 - 3.8.1、TSV封装设备
- 3.9、FC-PoP封装
- 3.10、IC载板产业

第四章、IC载板厂家研究

- 4.1、欣兴
- 4.2、IBIDEN
- 4.3、大德电子
- 4.4、SIMMTECH
- 4.5、LG INNOTEK



- 4.6、SEMCO
- 4.7、南亚电路板
- 4.8、景硕KINSUS
- 4.9、SHINKO
- 4.10、KYOCERA SLC
- 4.11、AT&S
- 4.12、珠海越亚封装基板
- 4.13、EASTERN

第五章、IC载板封装厂家研究

- 5.1、日月光
- 5.2、AMKOR
- 5.3、矽品精密
- 5.4、星科金朋
- 5.5、三菱瓦斯化学MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY
- 5.6、AJINOMOTO



图表目录

- 1994-2019年全球半导体市场规模
- 2015年全球半导体市场增速
- 1998-2019年全球半导体市场下游分布
- 2009-2019年全球半导体市场地域分布
- 2000-2019年全球半导体企业Capital
- 2012-2016全球半导体设备市场地域分布
- 2010-2019年Wafer Process Equipment Sales by Product
- 2014年全球半导体产业收入Top30
- 主要电子产品使用IC的封装类型
- 2012-2017年全球IC Packaging and Testing市场规模
- 2012-2017年全球Outsourcing IC Packaging and Testing市场规模
- 2012-2017年全球IC Packaging 市场规模
- 2012-2017年全球IC Testing市场规模
- 2009-2013年台湾封测产业收入
- 2013年全球前10大封装企业收入
- 2007-2015年全球手机出货量
- 2011-2014年全球3G/4G手机出货量地域分布
- Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)
- 2014年3季度全球十大手机厂家出货量
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)



- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2013 (Thousands of Units)
- 2013-2015年全球Top 13智能手机厂家出货量
- 2014年3季度主要智能手机厂家出货量
- 2013年1月-2014年12月中国手机市场月度出货量
- 2014年中国智能手机市场主要厂家市场占有率
- 2014年中国4G手机市场主要厂家市场占有率
- 2011-2016年全球平板电脑出货量
- Top Five Tablet Vendors, Shipments Fourth Quarter 2014
- Top Five Tablet Vendors, Shipments, Market Share, and Growth, Calendar Year 2014
- 2008-2015年CPU与GPU出货量
- 2008-2015年笔记本电脑出货量
- 2010-2014年全球主要笔记本电脑ODM厂家出货量
- 2012-2016年内存市场规模
- 2009-2016年IC载板市场规模
- 2009-2016年IC载板分技术市场规模
- IC载板具体应用产品
- Mobile DRAM Trend
- WIDE IO的优点
- SK Hynix WIDE IO2 Roadmap
- HMC Architecture
- HMC BENEFITS
- 内嵌被动与主动元件主板的优点



- Embedded Component Substrate Process
- Comparison of Embedded Active & Passive Components
- Roadmap of Embedded Passive Substrate
- Structure Roadmap of Embedded Active Substrate
- FOWLP and PLP Process Comparison
- WHY EMBEDDED TRACE?
- EMBEDDED TRACE Package Features
- EMBEDDED TRACE Package Sweet Spot (for Wire Bonding)
- EMBEDDED TRACE Package Sweet Spot (for FLIP CHIP)
- Apple iPad 4 LTE A1459 IC Package Type List
- PoP封装发展趋势
- 2.5D Interposer Manufacturing Revenue
- 2010-2017 Breakdown by interposer bulk material
- TSV下游应用
- TSV设备供应商
- 2012-2017年TSV封装设备分布
- 2010-2014年主要IC载板厂家收入
- 欣兴组织结构
- 2003-2014年欣兴收入与毛利率
- 2009-2014年欣兴收入与营业利润率
- 2012年1季度-2014年4季度欣兴季度收入与毛利率
- 2010-2014年欣兴销售额技术分布Sales Breakdown by Technology



- 2010-2014年欣兴收入下游应用分布Sales Breakdown by Application
- 2010-2014欣兴产能Capacity
- 2004-2013年欣兴CAPEX
- 欣兴历年合并
- 2006-2015财年IBIDEN收入与运营利润率
- 2006-2015财年IBIDEN收入业务分布
- 2012年2季度-2014年2季度IBIDEN季度收入业务分布
- 2012年2季度-2014年2季度IBIDEN季度营业利润业务分布
- 2010-2015财年ibiden电子事业部收入产品分布
- 2010-2015财年ibiden CAPEX与depreciation
- 2005-2014年大德电子收入与运营利润率
- 2009-2014年大德电子收入by business
- 2005-2014年大德GDS收入与运营利润率
- 2010-2014年大德GDS收入业务分布
- SIMM TECH组织结构
- 2004-2014年SIMMTECH收入与运营利润率
- 2009-2014年SIMMTECH收入、毛利率与净利率
- 2009-2013年SIMMTECH资产负债表
- 2013-2015年SIMMTECH 收入产品分布
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度毛利率与运营利润率
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度出货量
- 2012-2015年SIMMTECH出货量



- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度产能利用率
- 2012-2015年SIMMTECH产能利用率
- 2008-2014年SIMMTECH收入by application
- 2012-2014年SIMMTECH Substrate收入by application
- SIMMTECH厂区
- 2006-2015年LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2012年1季度-2014年4季度LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2011-2015年LG INNOTEK 收入业务分布
- 2011-2015年LG INNOTEK 运营利润业务分布
- 2009-2014年SEMCO收入与营业利润率
- 2010-2014年SEMCO收入部门分布
- 2013年1季度-2014年4季度SEMCO ACI事业部收入与运营利润率
- 2014年1季度-2014年4季度SEMCO HDI 与PKG收入
- 南亚电路板组织结构
- 2006-2014年南亚电路板收入与毛利率
- 2009-2015年南亚电路板收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月南亚电路板每月收入与增幅
- 南亚电路板产能与全球分布
- 2004-2014年景硕收入与毛利率
- 2009-2015年景硕收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月景硕每月收入与增幅
- 2011-2014年景硕收入产品分布



- 2011年景硕收入下游应用分布
- Q1/2014景硕收入BY Applications
- Q4/2014景硕收入BY Applications
- 2013\2014 KINSUS客户分布
- FY207-FY2015 Shinko收入与净利润
- 2010-2015财年Shinko收入业务分布
- FY2005-FY2015 AT&S与EBITDA率
- AT&S重庆substrate厂 ramp
- FY2014 AT&S收入业务与地域分布
- FY2015 AT&S收入业务与地域分布
- Q2/13-Q4/14 AT&S Mobile Devices & Substrates业务季度收入
- AT&S Mobile Devices & Substrates业务主要客户
- Q2/13-Q4/14 AT&S Industrial & Automotive 业务季度收入
- AT&S Industrial & Automotive 业务主要客户
- 2010-2015 AT&S员工数量
- 2010-2015 AT&S CAPEX
- 日月光组织结构
- 2005-2015年日月光收入与毛利率
- 2009-2015年日月光收入与营业利润率
- 2013年1月-2015年1月日月光月度收入
- 2010-2014年ASE收入业务分布
- 2013年1季度-2014年4季度ASE封装部门收入与毛利率



- 2013年1季度-2014年4季度ASE封装部门收入类型分布
- 2013年1季度-2014年4季度ASE材料部门收入与毛利率
- 2013年1季度-2014年4季度ASE IC业务收入下游分布
- 2013年1季度-2014年4季度ASE EMS收入与毛利率
- 2013年1季度-2014年4季度ASE EMS收入breakdown
- 2005-2014年Amkor收入与毛利率、运营利润率
- 2007-2014年Amkor收入封装类型分布
- 2012-2014 Amkor Packaged units
- 2012-2014年Amkor收入下游分布
- 矽品精密工业组织结构
- 2003-2014年矽品收入、毛利率、运营利润率
- 2013年1月-2015年1月SPIL月度收入
- 2012年4季度-2014年4季度SPIL季度收入、毛利率与营业利润率
- 2005-2014年矽品收入地域分布
- 2005-2014年矽品收入下游应用分布
- 2005-2014年矽品收入业务分布
- 矽品2006-2014年产能统计
- 2004-2014年星科金朋收入与毛利率
- 2014年星科金朋资产负债表
- 2006-2013年星科金朋收入封装类型分布
- 2006-2013年星科金朋收入下游应用分布
- 2006-2013年星科金朋收入 地域分布



- 星科金朋全球分布
- 2014年星科金朋收入地域与业务分布
- 三菱瓦斯化学Organization Chart
- 2009-2015财年MGC收入与营业利润
- 2009-2015财年MGC收入by segment
- 2009-2015财年MGC operation income by segment
- 2009-2015财年MGC information and advanced material 部门Capex and Depreciation
- ABF应用
- ABF制造流程
- ABF Construction
- Outline of manufacturing substrate using ABF
- Next build-up material in demand



购买报告

价 格	电子版: 8500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 9000元	传真: 010-8260.1570
页数: 130页	邮箱: hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期: 2015-3	网址: www.pday.com.cn	
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201503/24512930.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

